



推奨基板取付け寸法

PC 基板厚: 1.6 ± 0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

	Y			2-316133-5
				2-316133-3
				2-316133-2
	X			1-316133-5
				1-316133-3
				1-316133-2

Copyright © 1995 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
mm²(AWG -)		mmφ		ダイナミック D-3200S 5.08 ピッチ (V) 6 極 ヘッダーアセンブリー	
MATERIAL		FINISH		DYNAMIC D-3200S 5.08 PITCH (V) 6 POS. HDR CONN. ASS'Y	
SEE NOTES 注記参照		SEE NOTES 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
DR. 26/JUL/95		DE. 26/JUL/95		SIZE LOC NUMBER	
K.IKEDA		K.IKEDA		A3 J C-316133	
CHK. 2/AUG/95		APP. 2/AUG/95		SCALE REV. SHEET	
Y.ISHIKAWA		S.MANABE		2-1 B 1 OF 1	
LTR REVISION RECORD DR CHK DATE					

NUMBER 316133
 METRIC
 3rd ANGLE PROJECTION
 DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT
 PRINT DIST
 AMP-J REV.10/83